

2016年3月期 第2四半期 決算説明会

2015年11月10日

TOWA株式会社

東証1部:6315

本日の主な説明内容

1. 2016年3月期 上期実績
2. 2016年3月期 業績予想
3. 2016年3月期 下期取組み
4. 「TOWA 10年ビジョン」と
「中期経営計画」に対する取組み
 - ◆ 連結子会社の事業譲受
 - ◆ 新規事業への取組み

本日の主な説明内容

1. 2016年3月期 上期実績

2. 2016年3月期 業績予想

3. 2016年3月期 下期取組み

4. 「TOWA 10年ビジョン」と

「中期経営計画」に対する取組み

◆ 連結子会社の事業譲受

◆ 新規事業への取組み

2016年3月期 第2四半期(累計) 連結業績結果

(億円)

	期初計画	実績
売上高	109.0	111.2
営業利益	9.3	11.5
経常利益	9.3	12.0
純利益	7.9	11.6

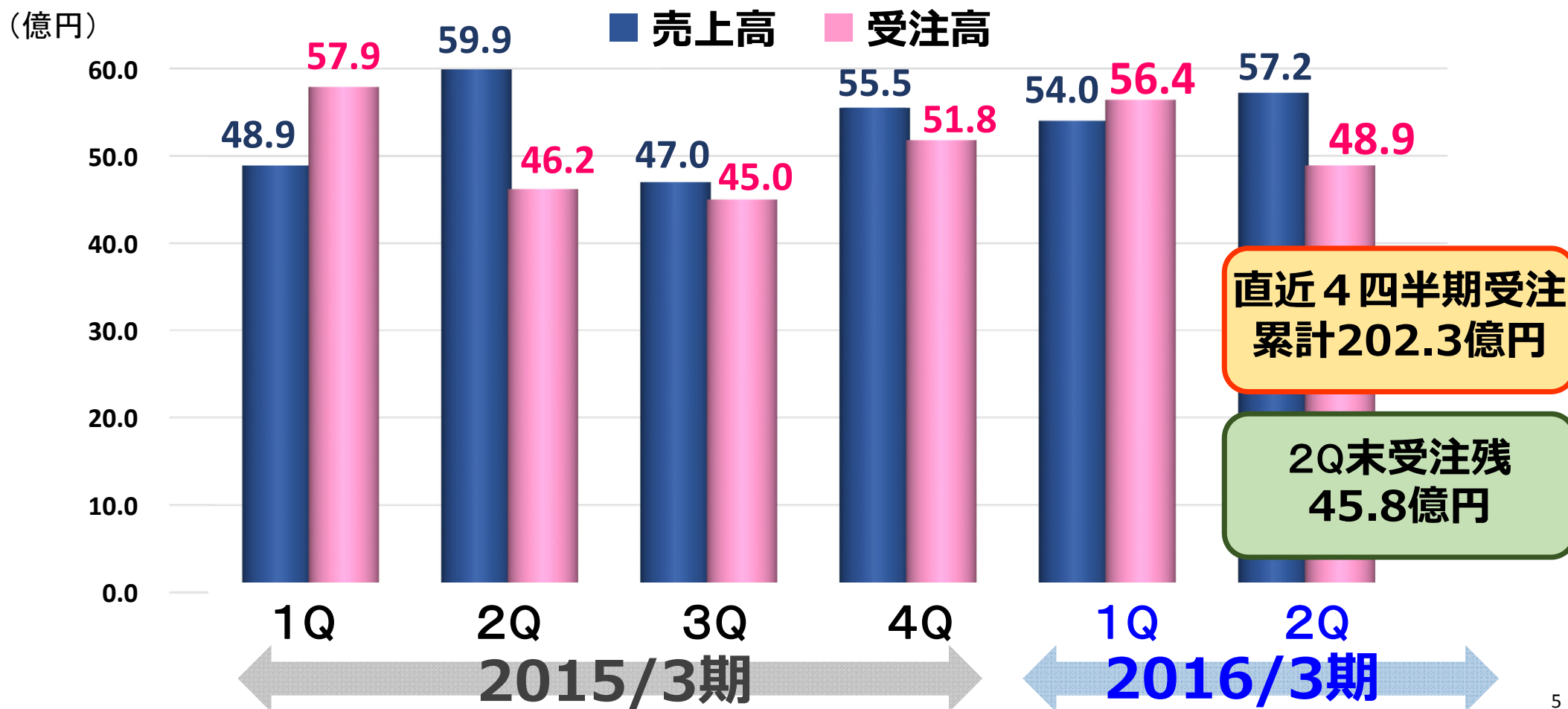
※純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

2016年3月期 第2四半期(累計) セグメント別売上高

(億円)

	2Q計画	2Q実績
売上高	109.0	111.2
半導体製造用等精密金型	32.0	31.1
モールディング装置	56.0	63.7
LED樹脂封止装置・金型	7.0	5.6
シンギュレーション装置	6.0	3.7
ファインプラスチック成形品	6.5	6.0
新たな市場	1.5	0.8

受注高・売上高の推移



本日の主な説明内容

1. 2016年3月期 上期実績

2. 2016年3月期 業績予想

3. 2016年3月期 下期取組み

4. 「TOWA 10年ビジョン」と

「中期経営計画」に対する取組み

◆ 連結子会社の事業譲受

◆ 新規事業への取組み

2016年 3月期 (通期)連結業績予想

(億円)

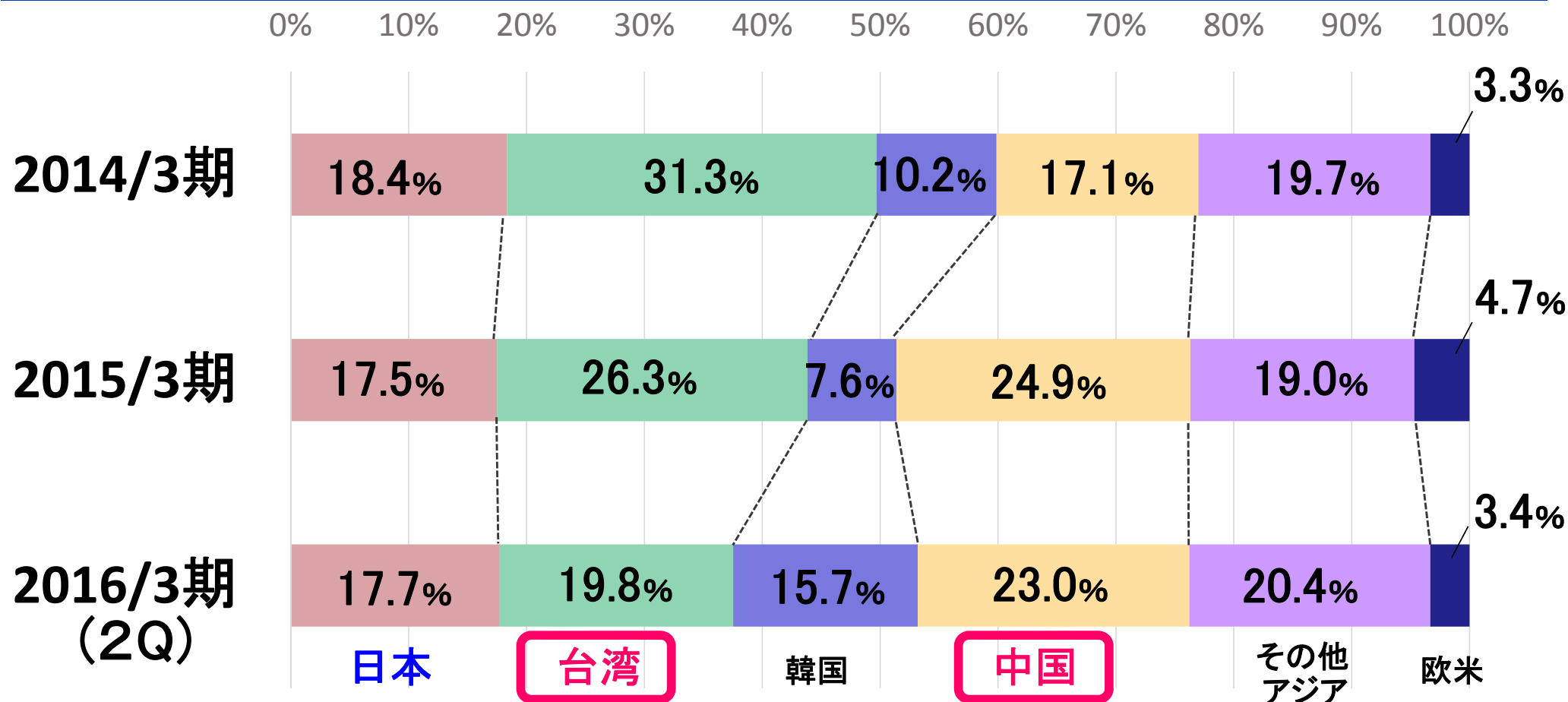
	期初計画	10/21修正	増減額
売上高	225.0	197.0	▲28.0
営業利益	23.5	9.0	▲14.5
経常利益	23.5	9.0	▲14.5
純利益	19.7	8.0	▲11.7

2016年 3月期 セグメント別売上高計画

(億円)

	期初計画	修正計画	増減率
売上高	225.0	197.0	▲12.4%
半導体製造用等精密金型	65.0	57.0	▲12.3%
モールディング装置	115.0	104.0	▲ 9.6%
LED樹脂封止装置・金型	15.0	10.0	▲33.3%
シンギュレーション装置	12.0	8.0	▲33.3%
ファインプラスチック成形品	13.0	13.0	—
新たな市場	5.0	5.0	—

地域別売上構成比率推移(仕向地ベース)



中国市場における成長見通し

半導体の 国産化



中国政府による国を挙げての 半導体産業発展のシナリオ

「国家 I C 産業発展推進ガイドライン」 (2014年6月)

- ・ 2015年の国内の半導体売上高を約6兆6,000億円 (3,500億元) に。
ミドルクラス以上の構成比を30%へ。
300mmウェハの製造等。
- ・ 2030年までに世界トップクラスの半導体企業を複数育成。

さらに「**国家産業投資基金**」という名称で
2兆円規模の基金を設立、半導体分野に投資を行う。

中国市場における成長見通し

《中国企業による主なM&A案件》

被買収企業	買収企業	金額 (億円)	
STATS ChipPAC (シンガポール)	長電	900	(10 億\$)
AMD組立工場 (米)	南通富士通	480	(4 億US\$)
オムニビジョン (米)	Huaキャピタル など	2,300	(19 億US\$)
NXP [RFパワー部門] (オランダ)	JACキャピタル	2,200	(18 億US\$)
マイクロン (米)	紫光集団	28,000 (提案中)	(230 億US\$)

配当計画

	2013/3期	2014/3期	2015/3期	2016/3期 計画
配 当	10.0円	10.0円	10.0円	10.0円
(連結配当性向)	(36.2%)	(44.0%)	(12.9%)	(31.3%)

※配当方針「安定・継続配当」に基づき、期末10.0円を予定。

本日の主な説明内容

1. 2016年3月期 上期実績

2. 2016年3月期 業績予想

3. 2016年3月期 下期取組み

4. 「TOWA 10年ビジョン」と

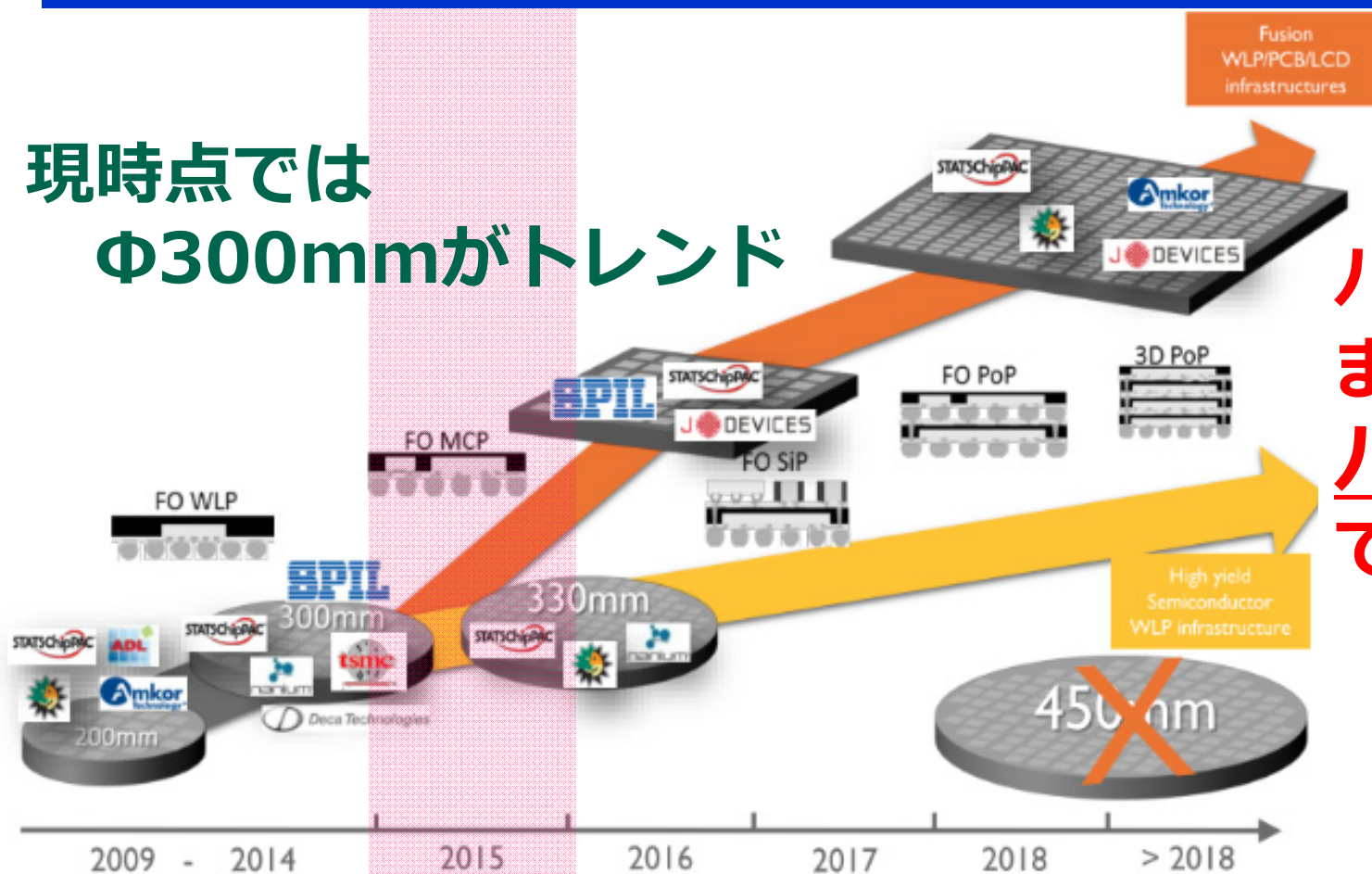
「中期経営計画」に対する取組み

◆ 連結子会社の事業譲受

◆ 新規事業への取組み

パッケージサイズのトレンド

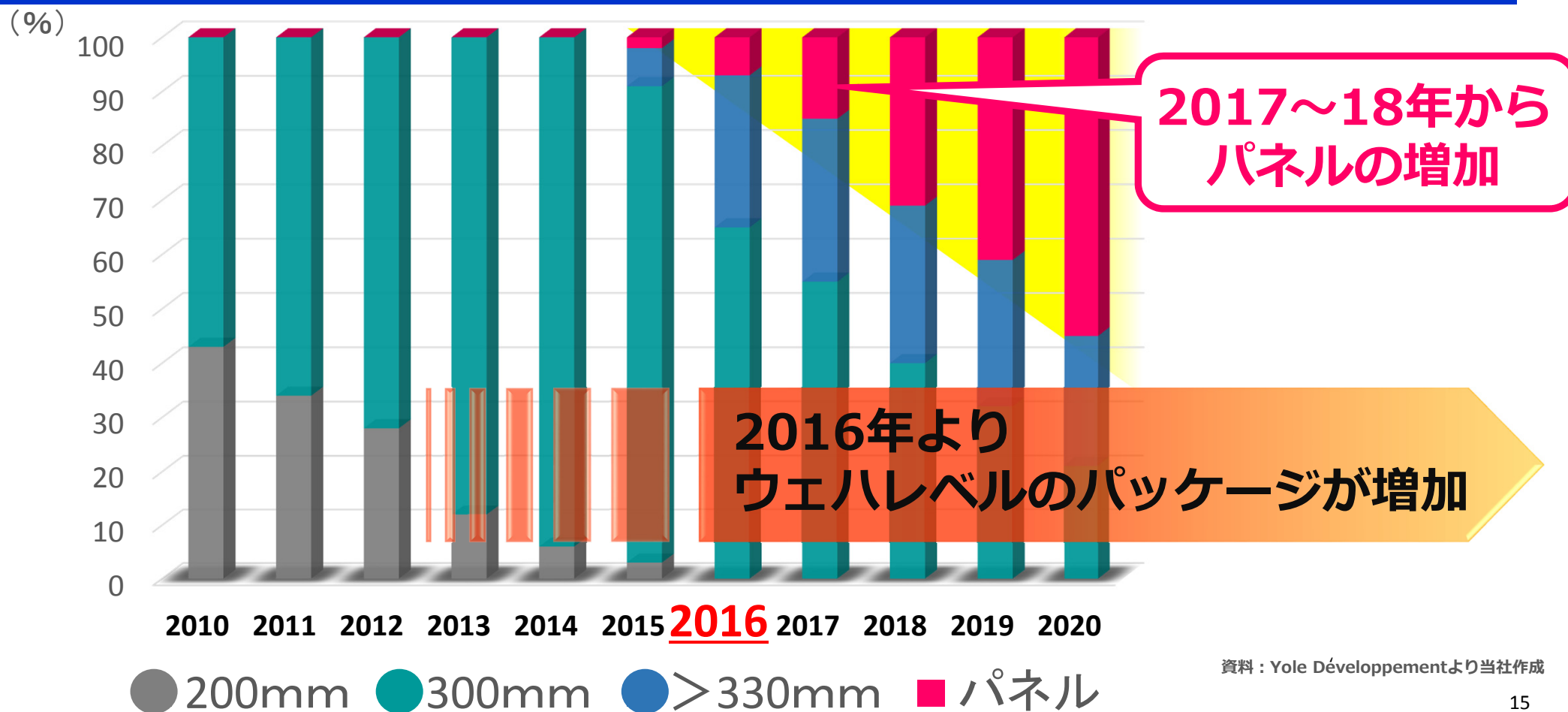
現時点では
Φ300mmがトレンド



パッケージサイズは、
ますますの大判化・
パネル化へと変遷し
ていく

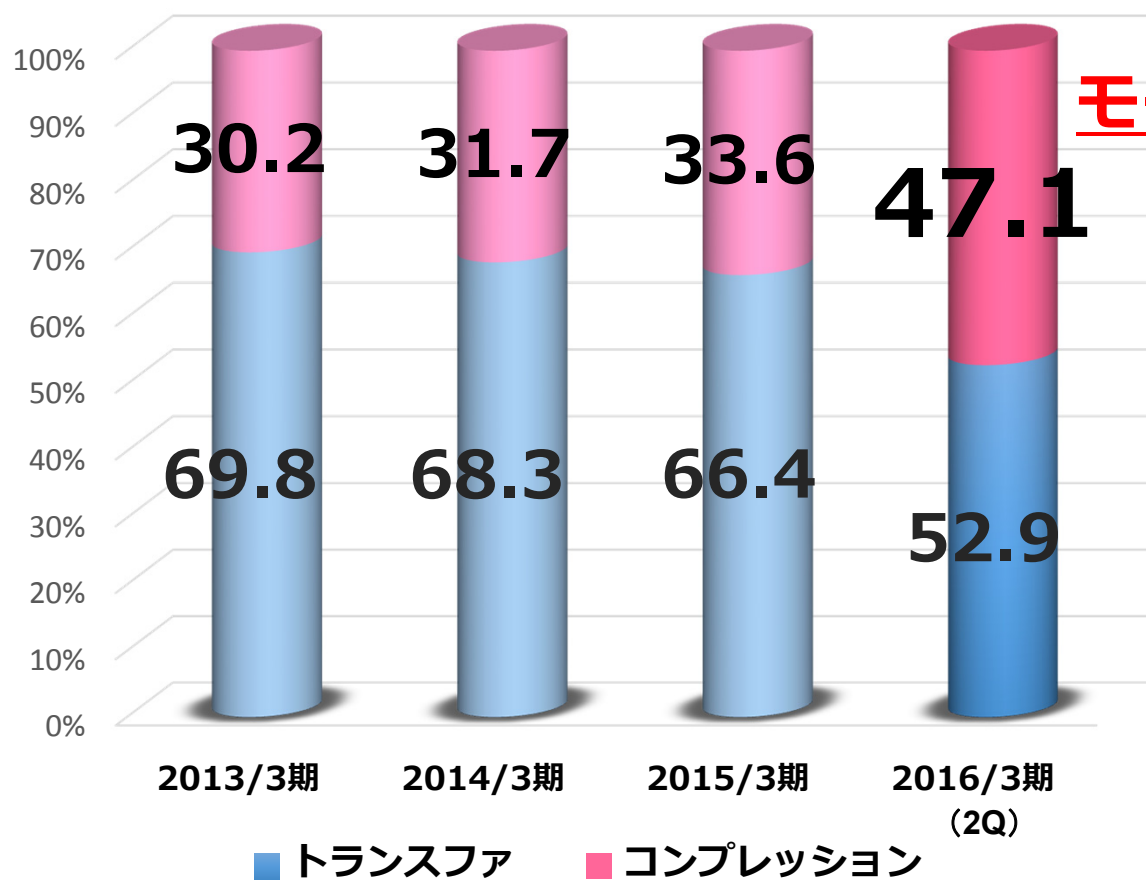
資料 : Yole Développementより当社作成

基盤サイズのトレンド(FOWLIPキャリア)



資料：Yole Développementより当社作成

コンプレッション装置のニーズ拡大



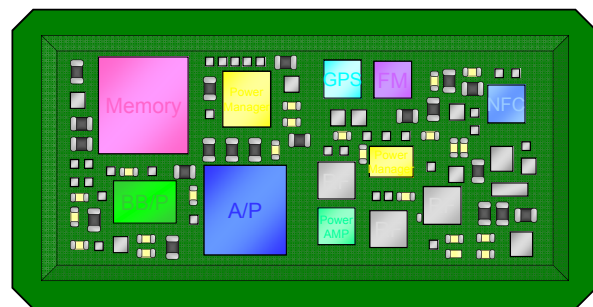
モールドディング装置売上高に占める
コンプレッションモールド
装置比率増加!

2009年、世界に先駆けて
当社独自のコンプレッション技術で
商品化に成功

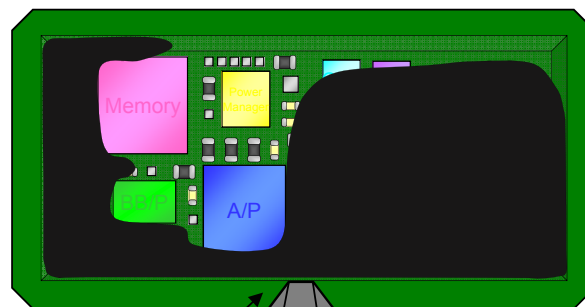
ハイエンドパッケージの成形に不可欠な
装置としてマーケットが認知

トランスファとコンプレッションの比較

製品



トランスファモード



コンプレッションモード



大判・薄厚・形状問わず、均一で高品質な仕上がりに

大判化への対応

半導体にとどまらず、基板分野にも展開！

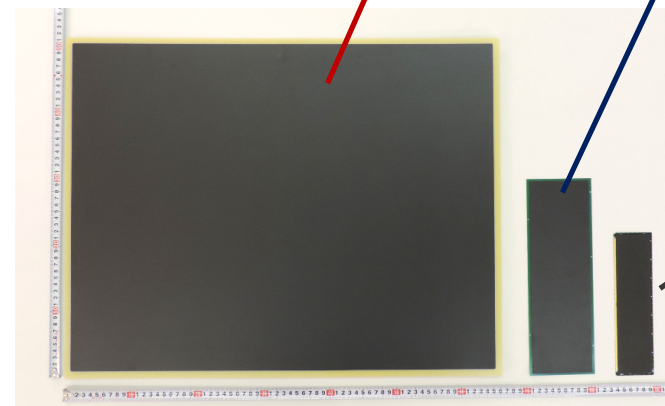
520×640サイズのパネルモールドサイズ対応のフルオート機の開発

CPM1180 Full Auto System



TOWAの先行技術
520×640mm

現在の先端基板
100×300mm



現在の量産基板
60×220mm

CPM1080

WLP(FOWLP)著しい成長

1 立ち上げから量産まで

WLPに対する総合展開
液状樹脂・顆粒樹脂

2 高品質達成

- 安定した確実な樹脂充填性
- パッケージ厚み $\pm 10\mu\text{m}$ 達成

3 TOWA基礎技術

- LEDで培われた液状樹脂取り扱いノウハウ
- コンプレッション成形で培われた均一樹脂供給技術
- 高精度位置決めプレス（ホールドフレーム構造）
- 高速高真空能力（FM技術）2 Torrを2秒で達成

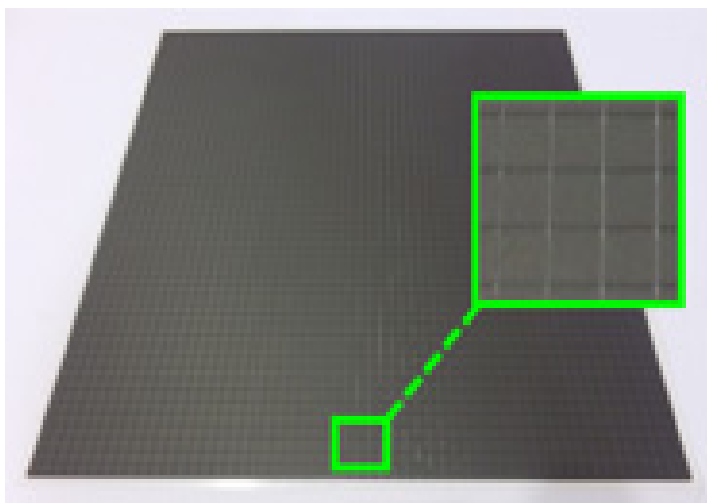
CPM1080



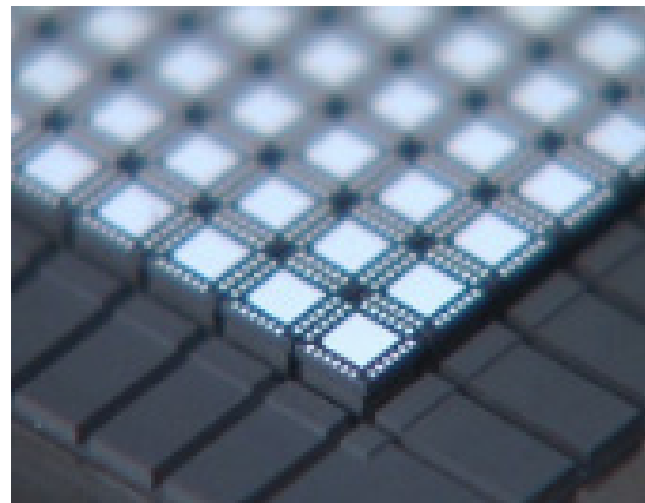
シンギュレーション技術

大判化トレンド（パネルサイズ）への対応

- 300mm対応のフルオート機について、今期末までに開発完了を計画



▲ 300x300mm パネルモールドカットサンプル

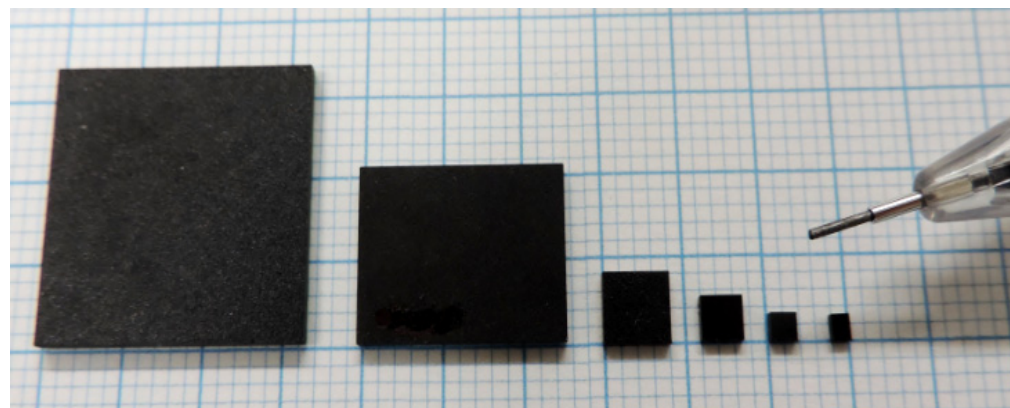


シンギュレーション技術

世界最小クラスのカッティング技術



▲FMS3040



1.6×1.0 mmカットサイズ対応のフルオート機の販売を開始

実績

前期より特定会社以外の一般顧客向けの販売を開始。
評価～機種認定先を拡大。拡販に向けたアクションを継続中。

前期売上 新規 4 社 **今期売上・受注 新規 6 社**

本日の主な説明内容

1. 2016年3月期 上期実績
2. 2016年3月期 業績予想
3. 2016年3月期 下期取組み

4. 「TOWA 10年ビジョン」と

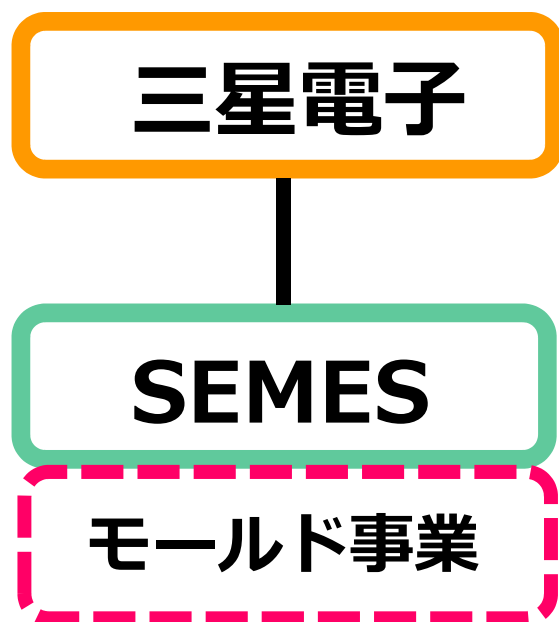
「中期経営計画」に対する取組み

◆ **連結子会社の事業譲受**

◆ 新規事業への取組み

TOWA 韓国の事業譲受について

三星電子の指定協力会社（第1ベンダー）
としての地位を引き継ぎ、
トータルソリューションの実現へ！



事業譲渡



パッケージング工程の開発・
生産・メンテナンスを中心とした
モールド工程包括事業！

TOWA 韓国の事業譲受について

- ・ 顧客囲い込み強化
- ・ 新たな事業機会の創出

シナジー効果

モールド事業部門

韓国最大の
半導体製造装置メーカー
装置・金型の製造・販売
三星電子グループで培った
ノウハウや高い技術力

SEMES

- ・ 営業
- ・ 技術
- ・ サービス
- ・ 改善提案
- ・ 開発

etc

TOWA韓国

業界のリーディング
カンパニーであるTOWAの
韓国拠点

装置・金型・部品の
販売とアフターサービス

TOWA
TOWA

本日の主な説明内容

1. 2016年3月期 上期実績
2. 2016年3月期 業績予想
3. 2016年3月期 下期取組み

4. 「TOWA 10年ビジョン」と

「中期経営計画」に対する取組み

- ◆ 連結子会社の事業譲受
- ◆ **新規事業への取組み**



用途開発及び用途に合ったプロセス開発！

ガラス

取り組み

展開

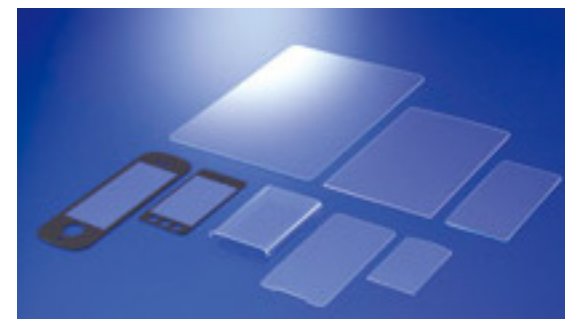
コンシューマー

受託加工



- スマホレンズ
- カバーガラス
- ナビゲーションカバー
- タブレットカバー

展開を想定した
リソースを確保





用途開発へ！



車載関連

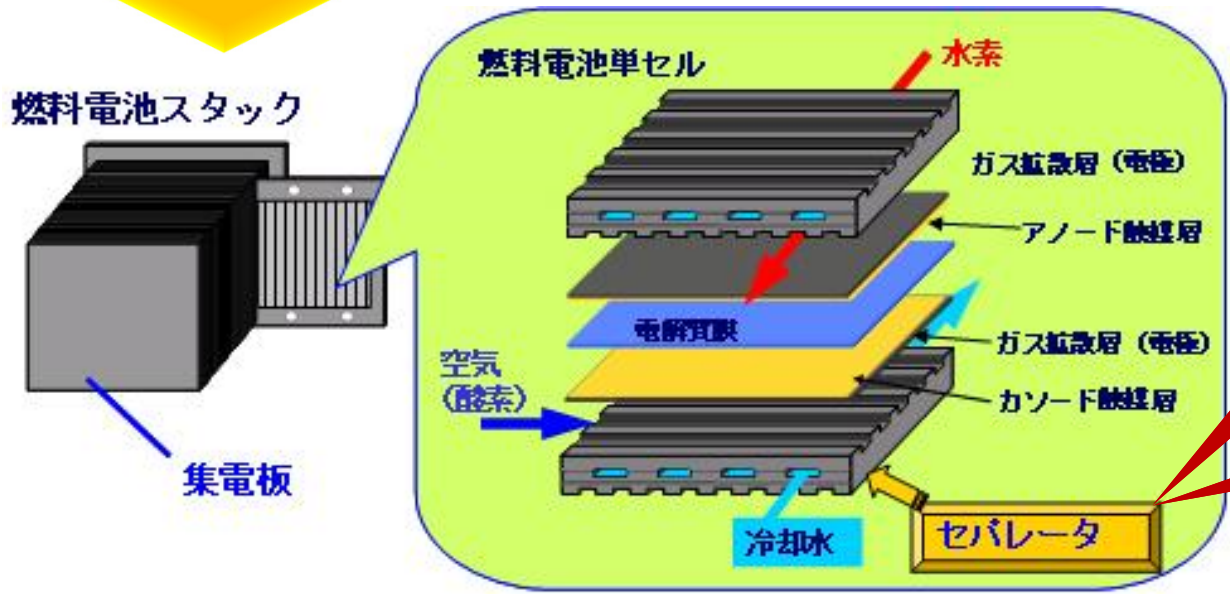
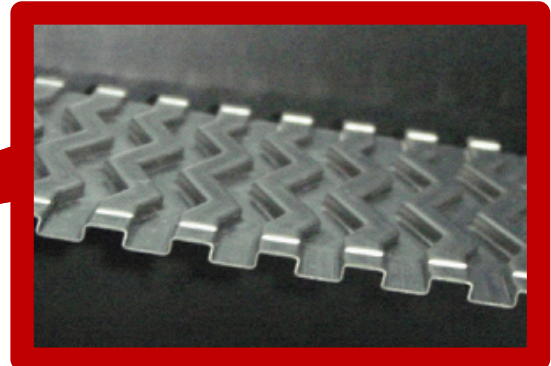
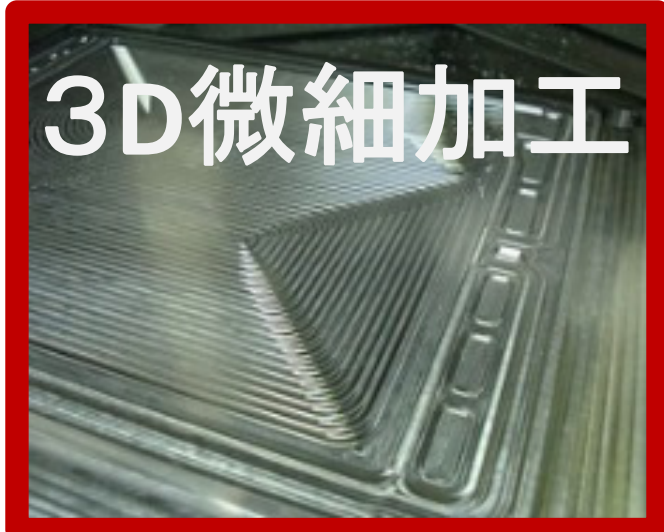
医療機器

精密受託加工

- 燃料電池部品
- HUD
- バルブ
- 二液混合ユニット
- 精密ノズル

**超精密
加工技術**

燃料電池部品



材料強化と離型性向上を同時達成！

バンセラ

取り組み

展開

高離型を実現

表面強化・防汚性



- 金型
 - ガラス
 - スマホ筐体
- etc...

打錠機部品やシリコン樹脂用金型への表面処理に

エンドミルで最終仕上まで！

工具

取り組み

展開

最小径 $\phi 0.05\text{mm}$ 達成！

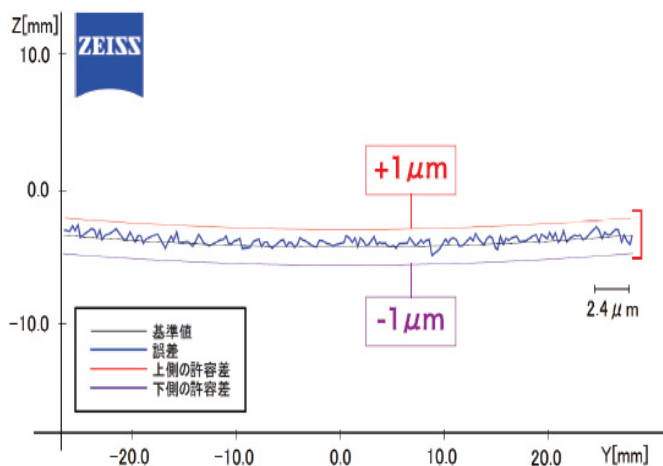
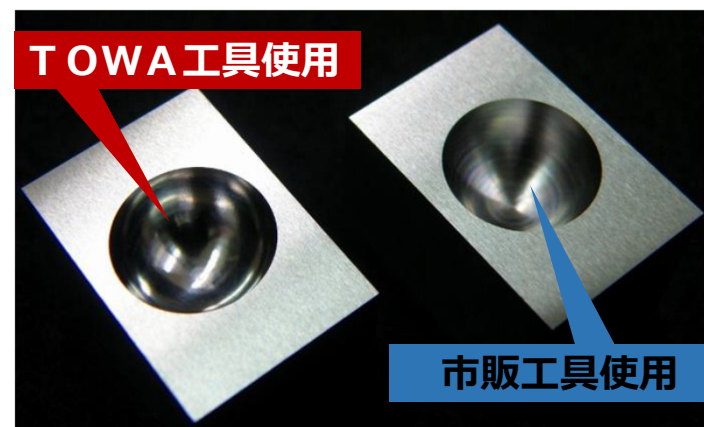
中国市場へも販売拡大！

テーパ

ボール

ラジアス

- ・ 驚異の高精度
(工具径精度 $0\sim-3\mu\text{m}$ / R精度 $\pm 2\mu\text{m}$)
- ・ お困りの加工について、
工具形状をご提案・提供
- ・ お客様のニーズにお応えし
再研削・特注品対応



製造現場へIoT提供！



TEN-SYSTEM構築

I o Tを用いクラウドサービスによる、
ビッグデータ解析技術を活用

- ・見えなかったものの『見える化』！
- ・状況を迅速に把握し対応を図る

装置診断が

可能に

稼働データとFSEで
工場稼働率向上

TEN-SYSTEM

(TOWA Engineering Network Service) =

データを収集、分析した結果を情報・サービスとして
出力（表示・通知・制御）できるネットワークシステム

顧客生産ラインの24時間／365日サポート



装置改善箇所



FEEDER

- ・オーバーロード機構ガタつき
- ・ボールネジ磨耗
- ・スライドブッシュ磨耗
- ・ギア磨耗バックラッシュ
- ・ストップ部磨耗
- ・LMガイド磨耗



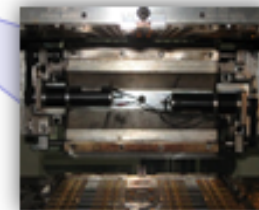
PICK UP

- ・ショックアブソーバー損傷
- ・ピックアップトラバース部
- ・ボールネジ損傷
- ・スライドブッシュ磨耗
- ・ベルト損傷



LOADER

- ・セットブロック磨耗
- ・ギア損耗
- ・カムフロア磨耗
- ・LMガイド損耗
- ・タイミングベルト損耗
- ・ケーブルベア劣化
- ・ブラケット損耗



UNLOADER

- ・ブラシ駆動ベルト磨耗
- ・プーリー磨耗
- ・カムフロア磨耗
- ・ギア損耗
- ・LMガイド損耗
- ・タイミングベルト損耗
- ・ケーブルベア劣化
- ・ブラケット損耗
- ・クリーナーゴムラバー損傷
- ・ゴムパッキン損傷
- ・集塵ホース損傷

TAB

- ・Parts Feeder 部品損耗
- ・オーバーフロー機構停止
- ・TAB確認センサー停止
- ・リングアタッチ部品磨耗
- ・ホッパー板金部品変形
- ・シリンダーエア漏れ
- ・TABガイド変形、磨耗
- ・LMガイド磨耗



PRESS

- ・ボールジャッキ損耗
- ・PIN C 磨耗



情報・ECO・ADAS・パワートレインへ加速！

※ADAS=Advanced Driver Assistance System 先進運転支援システム

車載関連

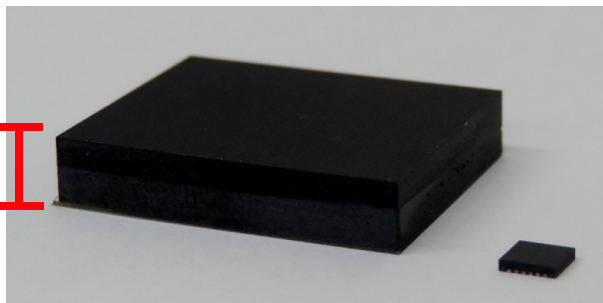
取り組み

展開

ECUユニット

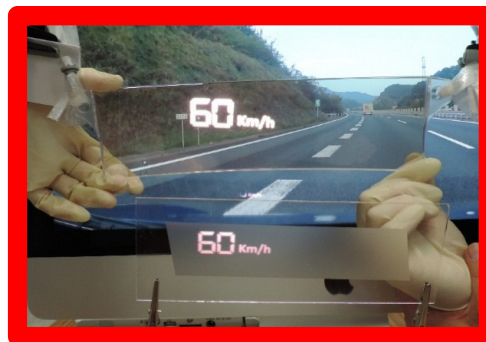
サイズが大きく、樹脂使用量が多い、
形状の複雑な成形にもTOWAの技術・
ノウハウを活用することで対応

6.0 mm

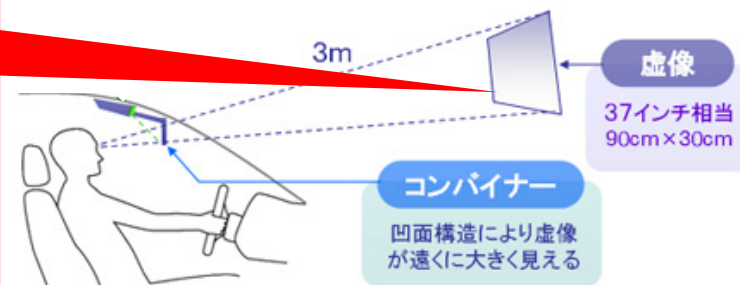


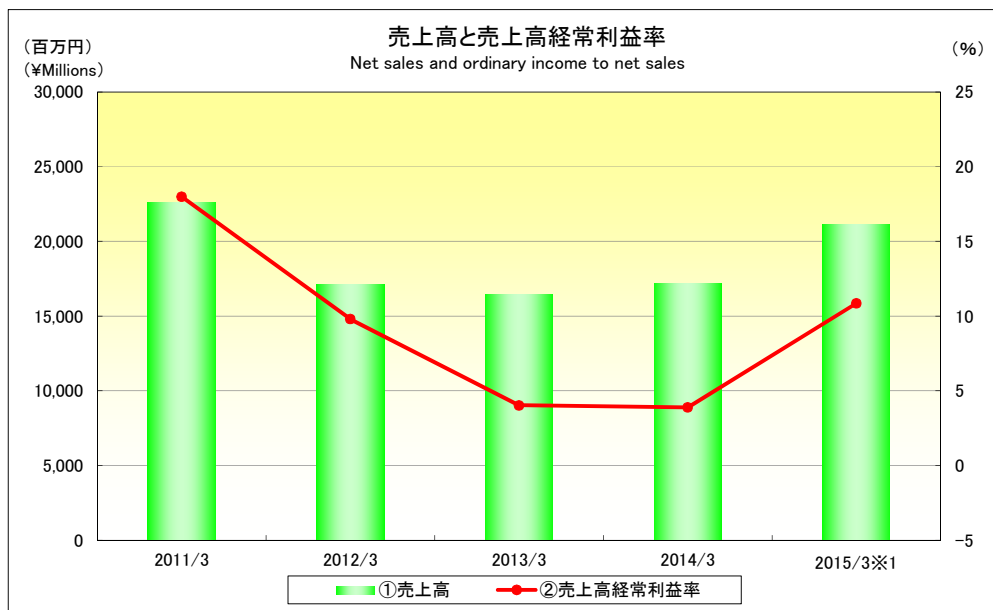
HUD・超精密加工

TOWA独自技術による高精度マイクロレンズアレイが
ヘッドアップディスプレイの高画質化を実現

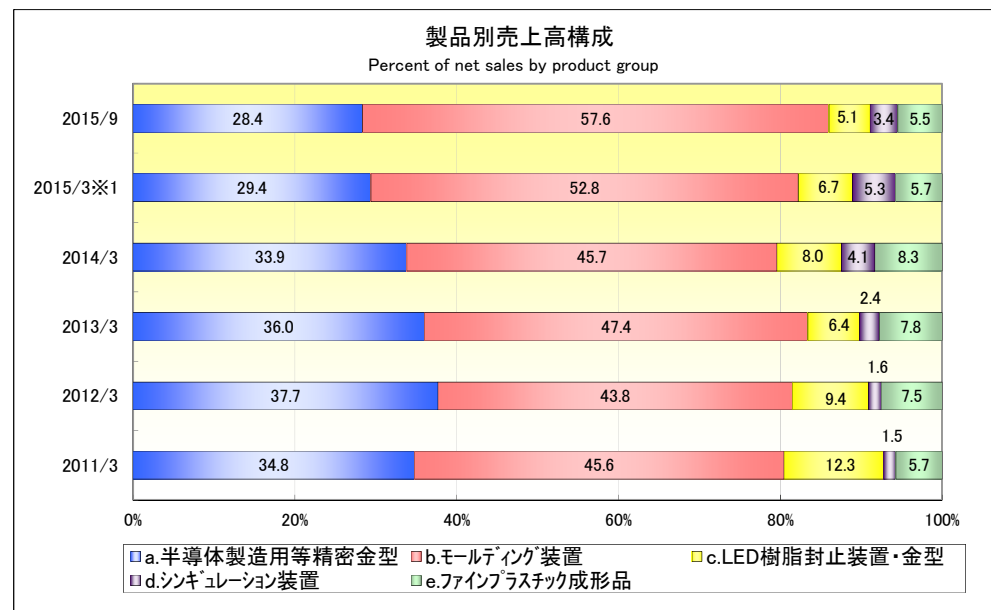


レーザーで写し出された映像





①Net sales ②Ordinary income to net sales



a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

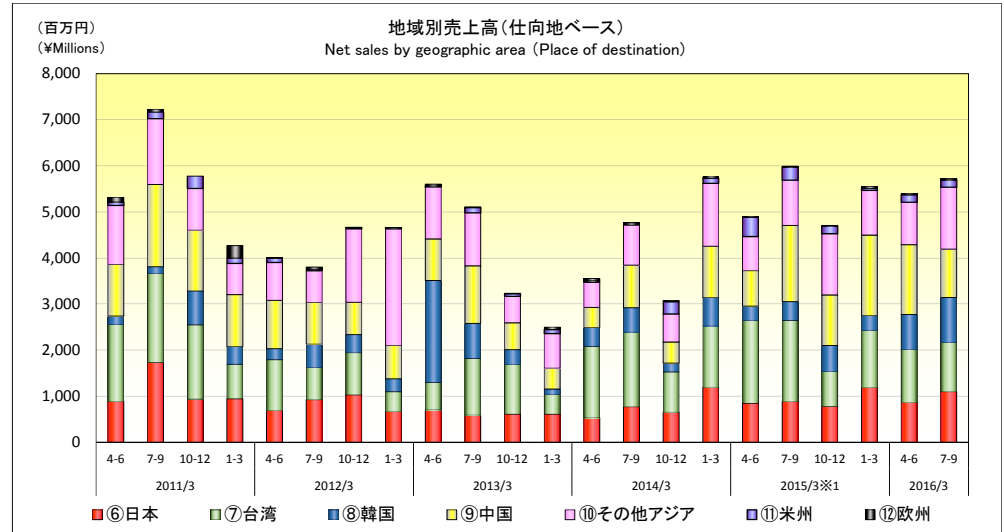
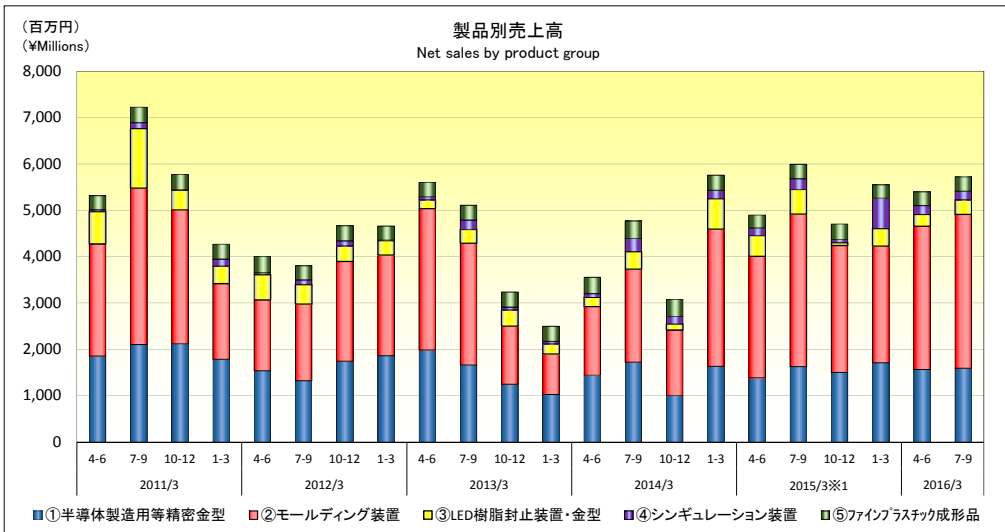
決算期	Fiscal year	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3※1	2016/3E
経営成績・財政状態 (百万円)	Operating results and financial conditions (¥Millions)						
売上高	Net sales	22,592	17,140	16,454	17,165	21,150	19,700
経常利益	Ordinary income	4,064	1,672	663	666	2,296	900
親会社株主に帰属する当期純利益 ※2	Profit attributable to owners of parent	3,751	968	691	568	1,934	800
総資産	Total assets	27,288	26,817	25,896	29,132	31,735	-
純資産	Net assets	14,771	15,926	17,072	17,909	21,060	-
1株当たり指標(円)	Per share data(¥)						
1株当たり当期純利益	Net income per share	150.00	38.71	27.64	22.72	77.35	31.99
諸指標(%)	Data(%)						
自己資本当期純利益率	Return on equity	29.0	6.3	4.2	3.3	10.1	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	15.0	6.2	2.5	2.4	7.5	-
売上高経常利益率	Ordinary income to net sales	18.0	9.8	4.0	3.9	10.9	4.6
自己資本比率	Equity ratio	54.1	59.4	65.2	60.6	65.4	-

(単位:百万円/¥Millions)		
	2014/9 ※1	2015/9
売上高	10,893	11,124
経常利益	1,452	1,205
親会社株主に帰属する当期純利益 ※2	1,077	1,167
総資産	31,650	30,905
純資産	19,528	21,491
1株当たり当期純利益	43.09	46.67
自己資本当期純利益率	-	-
総資産経常利益率	-	-
売上高経常利益率	13.3	10.8
自己資本比率	-	68.5

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2014/9」及び「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。

※2 2016年3月期より会計基準等の改正に伴い、従来の「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」となります。

II. 四半期売上高動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



製品別売上高 Net sales by product group

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3					2015/3※1					2016/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	5,995	4,706	5,550	21,150	5,401	5,722	11,124
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	1,026	5,923	1,443	1,723	1,009	1,634	5,810	1,383	1,625	1,500	1,711	6,220	1,565	1,590	3,156
モールドング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	2,421	3,371	2,888	1,630	10,313	1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	870	7,801	1,479	2,007	1,406	2,958	7,852	2,620	3,293	2,738	2,516	11,169	3,088	3,324	6,412
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	698	1,290	420	377	2,786	544	418	333	312	1,608	187	299	347	220	1,055	197	378	133	657	1,367	451	532	62	378	1,425	256	310	566
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	40	127	13	155	337	38	104	111	12	267	67	204	65	57	395	82	285	158	182	710	163	231	71	658	1,125	190	188	378
ファイナプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	304	332	332	319	1,289	359	303	323	301	1,287	311	318	322	325	1,277	351	377	367	327	1,424	279	311	333	285	1,210	300	308	609
月平均	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	834	1,371	1,185	1,591	1,025	1,920	1,430	1,632	1,998	1,569	1,850	1,763	1,800	1,907	1,854

(単位: 百万円/¥Millions)

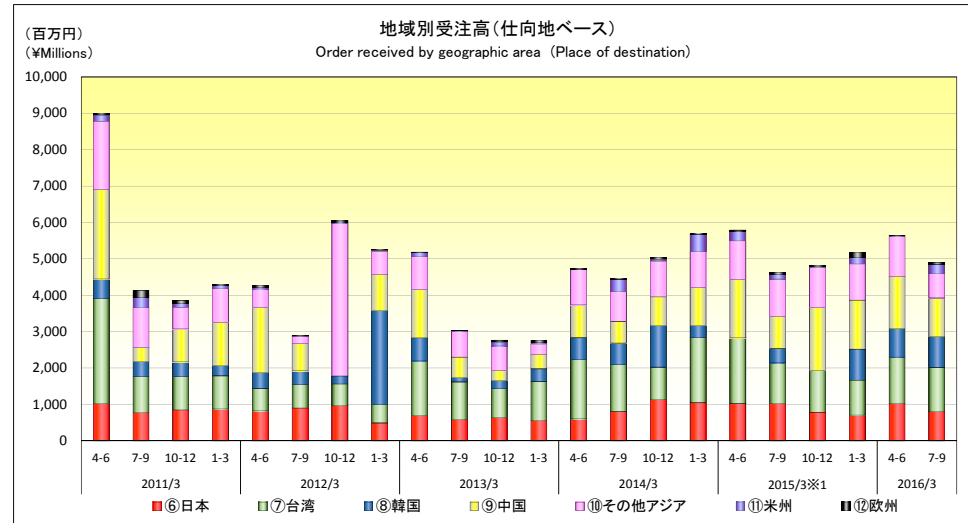
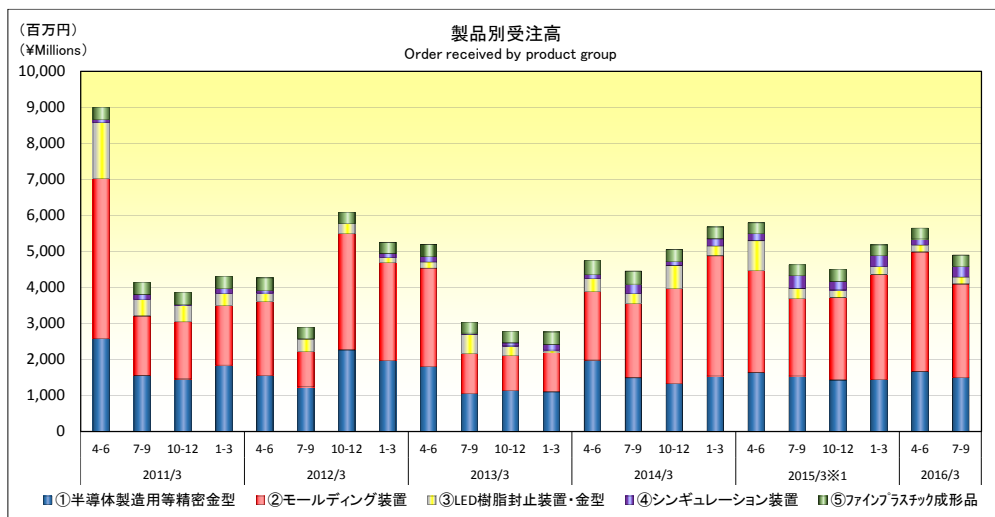
地域別売上高 (仕向地ベース) Net sales by geographic area (Place of destination)

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3					2015/3※1					2016/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
売上高合計 Total sales	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165	4,897	5,995	4,706	5,550	21,150	5,401	5,722	11,124
日本 ⑥Japan	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	614	2,521	527	772	654	1,195	3,150	849	884	776	1,190	3,701	870	1,100	1,970
台湾 ⑦Taiwan	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	423	3,314	1,556	1,619	873	1,326	5,376	1,800	1,761	762	1,241	5,565	1,137	1,069	2,207
韓国 ⑧Korea	187	152	737	380	1,458	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	119	3,428	408	528	189	618	1,745	305	408	561	319	1,594	768	973	1,741
中国 ⑨China	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	453	3,189	436	926	462	1,116	2,941	767	1,654	1,099	1,747	5,269	1,512	1,047	2,560
その他アジア ⑩Other asia	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	748	3,604	543	870	609	1,361	3,384	743	980	1,328	972	4,025	920	1,348	2,269
米州 ⑪America	70	145	268	117	602	94	32	25	11	164	14	112	53	89	269	31	20	263	112	428	418	282	162	40	904	163	154	318
欧州 ⑫Europe	103	55	0	270	423	10	47	4	11	74	44	16	12	52	126	51	34	23	29	137	12	23	15	39	89	27	28	55

(単位: 百万円/¥Millions)

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。

Ⅲ. 四半期受注高動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



製品別受注高 Order received by product group

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3					2015/3※1					2016/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,794	4,626	4,501	5,182	20,104	5,648	4,897	10,545
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	1,101	5,083	1,980	1,490	1,326	1,539	6,336	1,633	1,539	1,428	1,453	6,054	1,661	1,502	3,164
モールドング装置 ② Semiconductor plastic encapsulation systems	4,437	1,651	1,587	1,657	9,334	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	1,103	5,934	1,904	2,067	2,643	3,339	9,954	2,842	2,144	2,294	2,909	10,191	3,324	2,594	5,918
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	1,546	465	454	335	2,801	227	348	289	147	1,013	168	529	270	53	1,021	365	275	642	273	1,556	820	289	204	210	1,524	193	192	385
シンギュレーション装置 ④ Singulation parts and systems	101	132	35	142	411	73	16	-29	103	164	160	30	90	158	439	107	257	101	198	664	203	350	240	316	1,111	166	302	469
ファイナプラスチック成形品 ⑤ Engineering plastic molded products	316	327	326	327	1,298	350	307	309	313	1,281	322	306	304	346	1,279	383	362	335	327	1,409	294	303	333	292	1,223	302	304	607
月平均	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	921	1,147	1,580	1,485	1,683	1,892	1,660	1,931	1,542	1,500	1,727	1,675	1,883	1,632	1,758

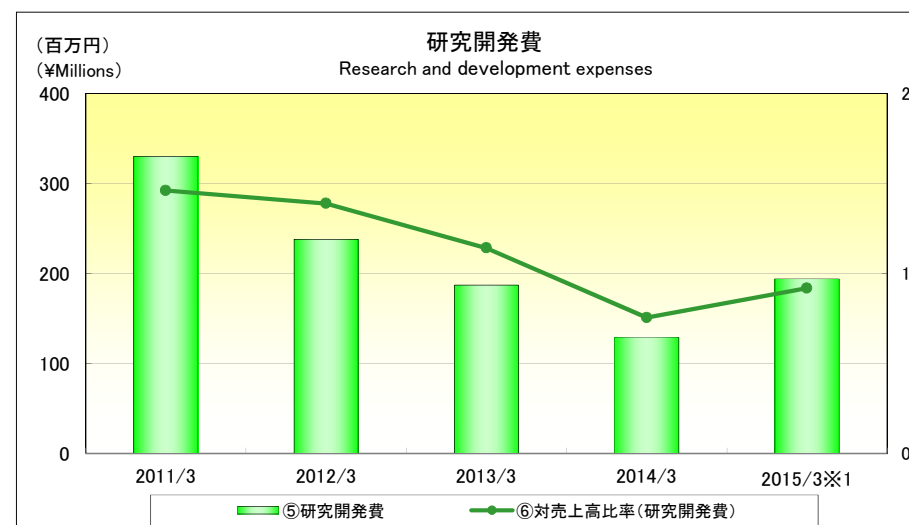
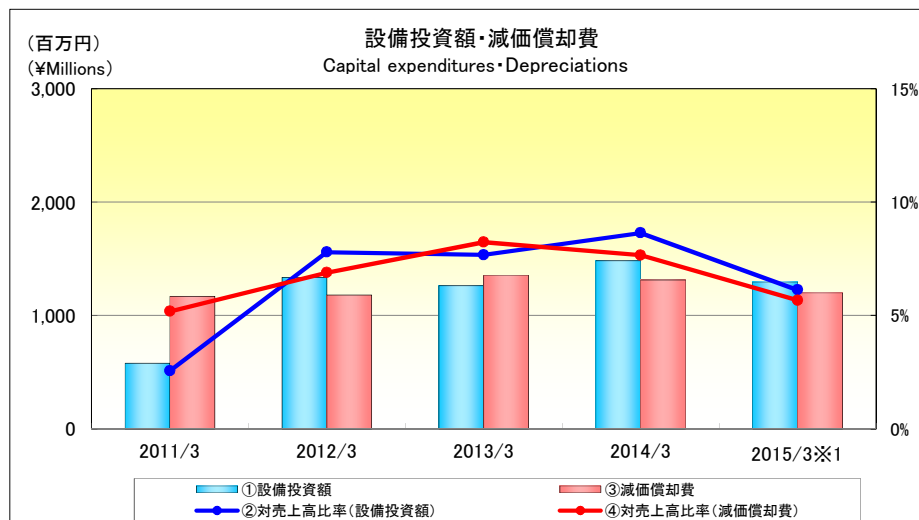
地域別受注高 (仕向地ベース) Order received by geographic area (Place of destination)

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3					2015/3※1					2016/3		
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	上期
受注高合計 Total order received	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921	5,794	4,626	4,501	5,182	20,104	5,648	4,897	10,545
日本 ⑥ Japan	1,038	781	853	875	3,548	821	906	963	495	3,187	703	593	645	551	2,494	602	802	1,130	1,048	3,583	1,023	1,036	789	709	3,558	1,035	795	1,831
台湾 ⑦ Taiwan	2,863	992	921	913	5,691	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	1,079	4,392	1,639	1,299	894	1,793	5,626	1,805	1,106	1,150	962	5,024	1,265	1,220	2,485
韓国 ⑧ Korea	546	415	395	277	1,635	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	352	1,328	592	583	1,139	330	2,645	1	392	-319	853	928	786	853	1,640
中国 ⑨ China	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	-8	981	3,520	1,327	564	284	389	2,566	902	598	794	1,046	3,341	1,608	887	1,735	1,345	5,578	1,423	1,056	2,480
その他アジア ⑩ Other asia	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	293	2,579	966	823	990	989	3,770	1,060	1,023	1,089	994	4,168	1,101	677	1,779
米州 ⑪ America	168	268	95	90	623	44	19	27	25	117	99	16	112	34	263	17	330	49	467	864	266	130	39	173	611	25	248	274
欧州 ⑫ Europe	29	188	84	26	329	43	4	46	9	104	16	13	42	62	134	20	16	50	2	89	27	49	15	142	234	8	44	53

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結) 決算期	(Consolidated) Fiscal year	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3※1	2015/9	2014/9※1
キャッシュフロー	Cash flows							
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	5,571	1,897	2,710	935	2,590	1,415	1,432
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-620	-112	-1,083	-1,553	-1,430	-321	-1,067
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-3,808	-2,280	-817	819	-1,170	-1,212	67
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	4,933	4,395	5,266	5,533	5,617	5,350	6,058
設備投資額	①Capital expenditures	578	1,336	1,262	1,482	1,295	377	475
対売上高比率(%)	②Ratio of sales (%)	2.56	7.79	7.67	8.64	6.13	3.39	4.36
減価償却費	③Depreciations	1,170	1,181	1,354	1,314	1,199	583	577
対売上高比率(%)	④Ratio of sales (%)	5.18	6.89	8.23	7.66	5.67	5.25	5.30
研究開発費	⑤Research and development expenses	330	238	187	129	194	117	97
対売上高比率(%)	⑥Ratio of sales (%)	1.46	1.39	1.14	0.75	0.92	1.05	0.90

※1 2016年3月期より会計方針の変更を行っているため、「2014/9」及び「2015/3」については、遡及適用後の数値を記載しております。

この資料に関するお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0273

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。